

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2006年4月6日 (06.04.2006)

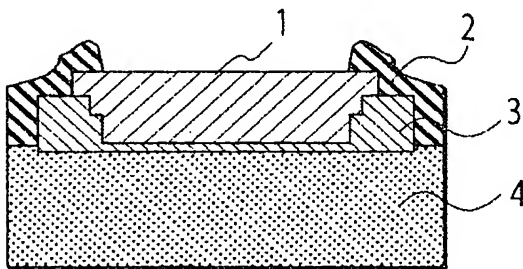
PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2006/035495 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C08L 101/00, (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014172
- (22) 国際出願日: 2004年9月28日 (28.09.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川上 広幸 (KAWAKAMI, Hiroyuki) [JP/JP]. 山口 玲子 (YAMAGUCHI, Reiko) [JP/JP]. 野村 好弘 (NOMURA, Yoshihiro) [JP/JP].
- (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル 9階 Tokyo (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: HEAT-RESISTANT RESIN PASTE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 耐熱性樹脂ペースト及びその製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a heat-resistant resin paste which is excellent in adhesiveness, heat resistance and flexibility and enables to form a precision pattern. This heat-resistant resin paste also enables to shorten the production time. Also disclosed is a method for producing such a heat-resistant resin paste. The heat-resistant resin paste is characterized by containing a first organic solvent (A1), a second organic solvent (A2) containing lactones, a heat-resistant resin (B) which is soluble in an organic solvent mixture of (A1) and (A2), and a heat-resistant resin filler (C) which is soluble in (A1) but not soluble in (A2). The heat-resistant resin paste is further characterized in that (C) is dispersed in a solution containing (A1), (A2) and (B).

(57) 要約: 本発明は、精密パターンを形成することが可能であり、密着性、耐熱性、可とう性に優れ、かつ生産時間を短縮できる耐熱性樹脂組ペースト及びその製造方法を提供することを目的とする。本発明は、第一の有機溶媒 (A1)、ラクトン類を含有してなる第二の有機溶媒 (A2)、(A1) と (A2) の混合有機溶媒に可溶である耐熱性樹脂 (B)、及び、(A1) に可溶であり (A2) に不溶である耐熱性樹脂フィラー (C) を含み、(A1)、(A2) 及び (B) を含む溶液中に (C) が分散してなることを特徴とする耐熱性樹脂ペーストに関する。

WO 2006/035495 A1